

EMI对策高密度焊接型冲压端子

RoHS

2D CAD
可从网页下载

焊接

镀金

EMI
对策Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

特长

EMI对策高密度焊接Dsub

- 壳体镀镍处理,有良好的EMI效果,具备一定抗电磁干扰力。
- 使用与以往的Dsub连接器相同尺寸的外壳,仅芯数超过以往产品的高密度型Dsub连接器。因此,可替代以往的Dsub型,实现配线的高密度化。
- 绝缘部材质达到UL94V-0等级。
- 焊接式连接器,作业时无需特殊工具。

基本规格

额定电流	额定电压	绝缘电阻(DC500V)	耐电压	接触电阻	使用温度
1A	500V(AC)	1000MΩ以上	750Vr.m.s	30mΩ以下	-55℃~+105℃

适用电线规格: AWG28~24或0.08mm²~0.2mm²

注意

- 连接器未带装配外壳及结合固定零件等。请另行订购。(▶602页)
- 78芯的产品为4排,其他芯数为3排。

Order
订货范例

型号

HDE-26SS

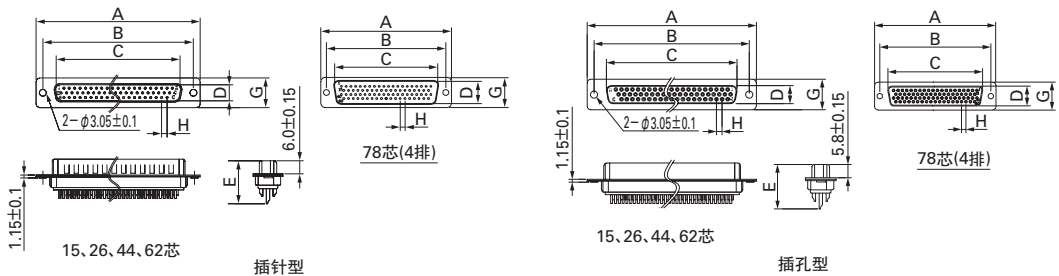
规格表

型号	芯数	端子形状	A±0.25 (mm)	B±0.13 (mm)	C±0.25 (mm)	D±0.25 (mm)	E±0.25 (mm)	G±0.25 (mm)	H±0.25 (mm)
			HDE-15SP	15	插针	30.81	24.99	16.92	8.38
HDE-26SP	26	39.25	33.32	25.25		8.38	17.0	12.55	2.29
HDE-44SP	44	53.04	47.04	38.96		8.38	17.0	12.55	2.29
HDE-62SP	62	69.50	63.50	55.42		8.38	17.0	12.55	2.41
HDE-78SP	78	67.02	61.02	52.75		11.03	17.0	15.35	2.41
HDE-15SS	15	插孔	30.81	24.99	16.33	8.0	16.5	12.55	2.29
HDE-26SS	26		39.25	33.32	24.66	8.0	16.5	12.55	2.29
HDE-44SS	44		53.04	47.04	38.38	8.0	16.5	12.55	2.29
HDE-62SS	62		69.50	63.50	54.84	8.0	16.5	12.55	2.41
HDE-78SS	78		67.02	61.02	52.36	10.9	16.5	15.35	2.41

1个起接受订购!

尺寸图

(单位: mm)



端子排列图

从接合面观察插针连接器的视图。

※面板安装尺寸请参见▶601页

类型	15芯	26芯	44芯	62芯	78芯
高密度型					

适用外壳

外壳类型	对应页码
EMI对策树脂外壳	▶625
通用金属外壳	▶627
90°弯角金属外壳	▶627
EMI对策快速插拔树脂外壳	▶628

M材质

项目	材质	表面处理/颜色
冲压端子	铜合金	镀镍底层接触部镀金
绝缘体	PBT(UL94V-0)	白色
外壳	钢	镀镍